



Instituto Tecnológico Argentino Técnico en Hardware de PC		
Plan THP2A03B	Reservados los Derechos de Propiedad Intelectual	
Tema: Montaje de componentes críticos	Archivo: CAP2A03BTHP0208.doc	
Clase N°: 08	Versión: 1.3	Fecha: 11/10/05

MONTAJE DE COMPONENTES CRÍTICOS

1 INSTALACIÓN DE MICROPROCESADORES

1.1 ENCAPSULADO FC-LGA

Land Grid Array es la nueva tecnología de encapsulado para procesadores Pentium IV Prescott, que incluye nuevas características las cuales estudiaremos mas adelante, este cuenta con:

- Disipador térmico sobre la superficie del núcleo del tipo Flip Chip
- 775 contactos y dos muescas de posicionamiento (Figura 8.1)

El socket 775 cuenta con:

- 775 pines
- Sistema de sujeción metálica del microprocesador (Figura 8.2).

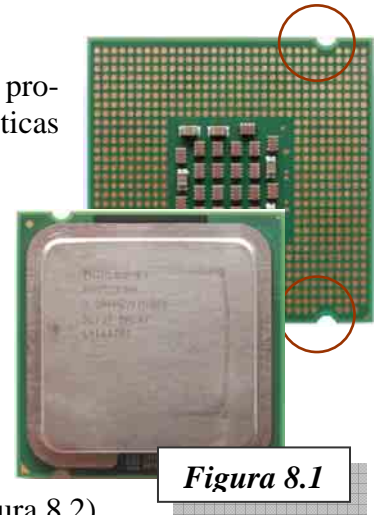


Figura 8.1

Instalación Encapsulado FC-LGA

El microprocesador cuenta con una cubierta protectora que impide al polvo ingresar en los contactos, el socket también posee un sistema de protección en el área de pines para evitar dañar la superficie. Se recomienda tener cuidado en la instalación del microprocesador utilizando guantes antiestática.

Metodología de instalación (Figura 8.3):

1. Quitar los plásticos protectores tanto del socket como del microprocesador.
2. Levantar la palanca del socket y luego el marco metálico
3. Ubicar las muescas de posicionamiento del microprocesador de forma que coincida con las del socket.
4. Instalar el microprocesador apoyando los contactos sobre el socket sin generar demasiada presión (Figura 8.3).
5. Bajar el mecanismo de retención y la palanca del socket.
6. Luego Instalar la torre de enfriamiento.



Figura 8.2

Instalación Encapsulado FC-LGA



Figura 8.3

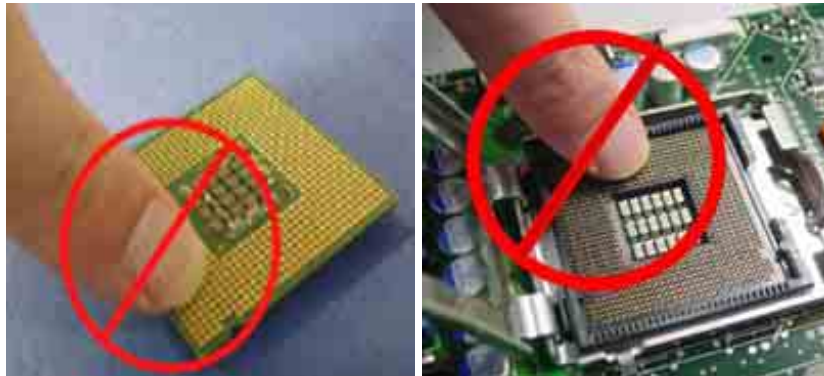
1.2 INSTALACION DE LA TORRE DE ENFRIAMIENTO



Se deben alinear las cuatro patas de la torre de enfriamiento con los agujeros provistos en el Motherboard, y generando una leve presión con el dedo en cada pata, estas deben atravesar los orificios quedando así fijas. Luego conectar la alimentación del microventilador.

1.3 MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

Estas imágenes explican como mantener en buenas condiciones al microprocesador y al socket. Utilizar en los dos casos los protectores plásticos provistos por el fabricante.

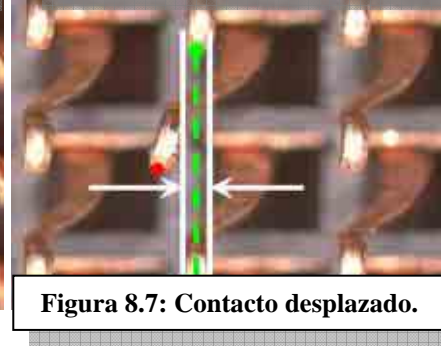
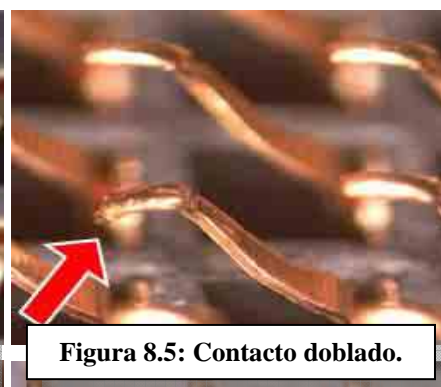


No tocar la superficie de contactos del socket y la del procesador



Utilizar los plásticos protectores provistos por el fabricante tanto para el Socket como para el Procesador.

1.4 DAÑOS IRREPARABLES OCASIONADOS EN LOS CONTACTOS DEL SOCKET



1.5 DESMONTAJE DE LA TORRE DE ENFRIAMIENTO.

1. Desconectar la alimentación eléctrica del cooler.
2. Al tirar hacia arriba el mecanismo de retención este girara unos 45° (Fig 8.8).
3. Luego de realizar la misma tarea sobre todas las patas del mecanismo desmontar la torre de enfriamiento
4. Para volver a poner la torre de enfriamiento, debemos poner en su posición original al mecanismo de retención girando las cabezas de las patas con la ayuda de un destornillador.

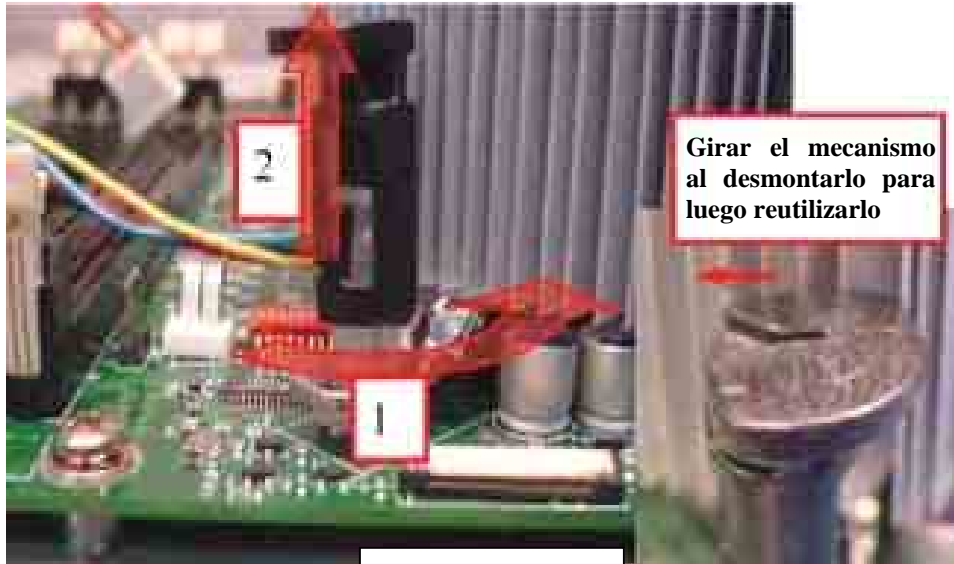


Figura 8.8

